

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路制造有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零五年九月三十日止三個月業績公佈

- 本公司謹於今日公佈截至二零零五年九月三十日止三個月的未經審核經營業績。銷售額由上季的 279,500,000 元升至二零零五年第三季的 310,000,000 元，升幅 10.9%。月產能增至 143,188 片 8 吋等值晶圓。二零零五年第三季的使用率為 92%，二零零五年第二季為 87%。二零零五年第三季的毛利率為 8.2%，二零零五年第二季毛利率為 2.3%。二零零五年第三季的淨虧損為 26,100,000 元，二零零五年第二季為淨虧損 40,400,000 元。
- 以下為本公司於二零零五年十月二十八日就截至二零零五年九月三十日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任而作出本公佈。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中芯二零零五年第三季業績報告

概要

- 銷售額由上季的 279,500,000 元升至二零零五年第三季的 310,000,000 元，升幅 10.9%。
- 月產能增至 143,188 片 8 吋等值晶圓。
- 二零零五年第三季的使用率為 92%，二零零五年第二季為 87%。
- 二零零五年第三季的毛利率由二零零五年第二季 2.3% 增至 8.2%
- 二零零五年第三季的晶圓付運比二零零五年第二季增加 7.5%，至 355,664 片 8 吋等值晶圓。

中國上海—二零零五年十月二十八日—國際主要半導體承包製造商中芯國際積體電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零五年九月三十日止三個月的綜合經營業績。二零零五年第三季銷售額由上一季度的 279,500,000 元上升 10.9%至 310,000,000 元。本公司二零零五年第三季的月產能增至 143,188 片 8 吋等值晶圓，使用率較二零零五年第二季的 87%升至二零零五年第三季的 92%。毛利率由二零零五年第二季的 2.3%增至二零零五年第三季的 8.2%。與二零零五年第二季淨虧損 40,400,000 元相比，二零零五年第三季的淨虧損減少至 26,100,000 元，。

“當我們專注於執行我們的計劃時，在第三季我們看到來自于先進主流技術的客戶們之大量訂單。”中芯國際總裁兼總執行長張汝京先生說，“我們增加的收益第一次有超過 90% 主要源自 0.18 微米及其以下技術的尖端制程。”

一年以來，我們企業繼續透過經營活動獲致大約 5 億美元價值的資金流通。本季末，我們有可使用的現金逾美金 5.77 億美元，及未使用之信用貸款逾 7 億美元。如此一來我們將可繼續投資高階技術與設備，以便服務我們的客戶。

在本季度中，本公司增加一個前五大無廠房新客戶，也同時和另一個前五大無廠房公司開始合作。我們正在擴張電腦周邊產品的相關製成，希望能與先進半導體公司合作更高階技術。我們同時也新增了 25 個設計定案產品，其中有超過三分之一來自中國大陸的客戶，三分之一的製成是使用 0.13 微米的技術。當我們著力於中國大陸的積體電路產業，我們成功地為重慶重郵資訊科技有限公司製造了世界第一個用於 TD-SCDMA 0.13 微米晶片。

我很高興地報告我們北京的研發部門已經在 90 奈米技術的研發中取得了很大的進步，客戶已經對本公司生產他們 90 奈米產品的能力表示滿意。我們通過驗證的產品已超越客戶的既定目標也達到產業平均水準。我們預計在第四季末前開始試產，之後將盡速開始量產。我們也將使用 Saifun 授權的 90 奈米邏輯制程技術來生產 2G NAND 快閃記憶體產品。我們亦與 Elpida 達成協定將北京 4 廠的 DRAM 制程自 100 奈米轉移到 90 奈米。

延續科技研發規畫，近來我們已與客戶達成協定，共同發展 65 奈米的制程，預期於二零零六年年底前完成工程樣本的製造。

我們在成都的測試封裝專案正如期進行中，將在第四季度開始試產，如此，我們便可以提供中國大陸全方位的製造服務，此外，基於記憶體和覆晶邏輯產品封裝廠的短缺，我們希冀可以開始量產來服務我們的客戶。

我們將繼續專注於本公司企業基本原則並承諾對投資大眾給付股東權益。 “

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零五年十月二十八日

時間：上海時間上午八時正

撥號及登入密碼：美國 1-617-224-4324 (密碼：SMIC) 或香港 852-3002-1672 (密碼：SMIC)。

二零零五年第三季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

有關中芯

中芯國際(NYSE: SMI, SEHK: 0981.HK)是世界領先的積體電路晶片代工廠之一，提供 0.35 微米到 0.11 微米及更先進工藝的晶片製造服務。公司 2000 年成立以來，其位於上海及天津的四座 8 英寸晶片廠均已量產。另外，其位於北京的 12 英寸晶片廠也於 2005 年第一季度開始量產。中芯國際還在美國、歐洲、日本、香港等地設立了辦事處，更好地服務于全球客戶。中芯國際致力於提供高品質的服務，全面執行國際標準，目前已經通過了 ISO9001 認證、ISO/TS16949 認證、OHSAS18001 認證、TL9000 認證 BS7799 認證以及 ISO14001 認證。如需更多資訊，敬請訪問公司網站：<http://www.smics.com>

安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995私人有價證券訴訟改革法案所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述(包括中芯預期產品發展、產品介紹和未來成果的聲明，例如關於提高中芯天津廠產能的投資的聲明、中芯各專案量產或試生產的成果的聲明及由此些專案使收益增加的聲明，正如在二零零五第四季指引中所述)乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，為并非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體承包製造服務供求情況、市場產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料，包括其於二零零五年六月二十八日以 20-F 表格形式呈交予證交會的登記聲明，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份、其於二零零四年三月八日以 A-1 表格形式呈交予香港聯合交易所(「香港聯交所」)的登記聲明，以及中芯可能不時向證交會及香港

聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可逆料的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則本新聞發佈日期）的情況而表述。

除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

投資者聯絡資料：

Jimmy Lai

投資者關係部負責人

電話：86-21-5080-2000，內線 16088

傳真：86-21-5080-3619

Calvin Lau

投資者關係部

電話：86-21-5080-2000，內線 16693

傳真：86-21-5080-3619

概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零五年 第三季度	二零零五年 第二季度	季度比較	二零零四年 第三季度	年度比較
銷售	309,959	279,500	10.9%	274,897	12.8%
銷售成本	284,686	273,111	4.2%	201,141	41.5%
毛利	25,273	6,389	295.6%	73,756	-65.7%
經營開支	46,219	38,469	20.1%	31,218	48.1%
經營溢利（虧損）	(20,946)	(32,081)	-34.7%	42,538	149.2%
其他收入（支出）	(5,602)	(8,234)	-32.0%	(3,195)	75.4%
所得稅	6	118	-94.9%	-	-
收入（虧損）淨額	(26,554)	(40,433)	-34.4%	39,343	-167.5%
少數股權	439	(12)	-	-	-
普通股持有人應占收入（虧損）	(26,115)	(40,445)	-35.4%	39,343	-166.4%
毛利率	8.2%	2.3%		26.8%	
經營利潤率	-6.8%	-11.5%		15.5%	
每股基本盈利－每股普通股(1)	(\$0.0014)	(\$0.0022)		\$0.0022	
每股基本盈利－每股美國預托股份	(\$0.0718)	(\$0.1113)		\$0.1095	
每股攤薄盈利－每股普通股	(\$0.0014)	(\$0.0022)		\$0.0022	
每股攤薄盈利－每股美國預托股份	(\$0.0718)	(\$0.1113)		\$0.1079	
付運晶圓（8吋等值）(2)	355,664	330,499	7.6%	263,808	34.8%
邏輯平均售價(3)	\$989	\$938	5.4%	\$1,091	-9.3%
綜合平均售價	\$841	\$807	4.2%	\$991	-15.1%
簡化平均售價(4)	\$871	\$846	3.1%	\$1,042	-16.4%
產能使用率	92%	87%		99%	

附注：

(1) 基於二零零五年第三季加權平均普通股 18,180,000,000 股，二零零五年第二季 18,169,000,000 股，二零零四年第三季 17,961,000,000 股。

(2) 包括銅接連件

(3) 不包括銅接連件

(4) 銷售總額/晶圓付運總數

- 二零零五年第三季銷售額升至 310,000,000 元，較二零零五年第二季的 279,500,000 元錄得季度升幅 10.9%，並較二零零四年第三季的 274,900,000 元錄得年度升幅 12.8%。導致此等上升的主要因素如下：
 - 月產能增至 143,188 片 8 吋等值晶圓
 - 8 吋等值晶圓付運升至 355,664 片，較二零零五年第二季的 330,499 片錄得季度升幅 7.6%；
 - 綜合平均售價季度增幅為 4.2%
 - 產能使用率增至 92%
- 銷售成本從二零零五年第二季的 273,100,000 元增加 4.2%至二零零五年第三季的 284,700,000 元，主要由於晶圓付運的增加，因市場預期價值的下降而引起的存貨價值下調以及許可產品的技術使用費支出。
- 二零零五年第三季毛利上升至 25,300,000 元，較二零零五年第二季的 6,400,000 元錄得季度升幅 295.6%；較二零零四年第三季的 73,800,000 元錄得年度降幅 65.7%
- 毛利率從二零零五年第二季的 2.3%升至二零零五年第三季 8.2%，主要是綜合平均售價有所提高。
- 研發費用從二零零五年第二季的 16,300,000 元上升 17.7%至二零零五年第三季 19,200,000 元，主要是由於 90 奈米的研究開發行為以及北京晶圓 6 廠啓動費用增加所致。
- 一般行政費用從二零零五年第二季 5,400,000 元上升 69.0%至二零零五年第三季 9,100,000 元，主要是由於與二零零五年第二季的匯兌收益 2,500,000 元相比，二零零五年第三季匯兌虧損為 300,000 元。
- 銷售及市場推廣相關費用從二零零五年第二季 3,000,000 元上升 35.2%至二零零五年第三季 4,100,000 元，主要是因為與銷售行為相關的工程材料費用的增加。
- 無形資產攤銷是指與所獲得無形資產相關的攤銷費用，此費用從二零零五年第二季 10,100,000 元上升 5.7%至二零零五年第三季 10,700,000 元。
- 經營虧損從二零零五年第二季的 32,100,000 元降為二零零五年第三季 20,900,000 元。
- 其他非營業性虧損由二零零五年第二季的 8,200,000 元下降 32.0%至二零零五年第三季的 5,600,000 元，主要由於二零零五年第二季度與非經營活動相關的匯兌虧損為 1,600,000 元，而二零零五年第三季與非經營活動相關的匯兌收益為 1,200,000 元。
- 二零零五年第三季的利息支出由二零零五年第二季的 9,000,000 元增加 15.2%至 10,300,000 元，主要是由於銀行借款的增加及利率的上升。
- 匯兌淨收益為 900,000 元，其中一般行政費用中包括了匯兌虧損 300,000 元，與融資或投資活動相關的（例：遠期合約）非經營性活動產生的匯兌收益 1,200,000 元歸類為其他收入（支出）。
- 二零零五年第三季淨虧損由二零零五年第二季淨虧損 40,400,000 元下降 35.4%至 26,100,000 元，

1. 收入分析

銷售分析					
以應用分類	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季
電腦	33.7%	39.8%	36.8%	26.8%	20.5%
通訊	39.8%	40.4%	44.5%	58.1%	57.2%
消費	22.8%	15.2%	13.6%	10.2%	17.1%
其他	3.7%	4.6%	5.1%	4.9%	5.2%
以裝置分類	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季
邏輯（包括銅接連件）	65.5%	58.9%	61.9%	75.1%	77.6%
DRAM	31.0%	36.4%	33.0%	20.4%	17.5%
其他（光罩製造及探測）	3.5%	4.6%	5.1%	4.5%	4.9%
以客戶類別分類	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季
非廠房半導體公司	43.2%	42.2%	48.1%	50.2%	35.3%
集成裝置製造商	52.8%	55.2%	49.6%	47.5%	56.3%
系統公司及其它	4.0%	2.6%	2.3%	2.3%	8.4%
以地區分類	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季
北美洲	42.9%	40.8%	40.4%	34.9%	41.8%
亞太區（不包括日本）	25.7%	26.3%	26.9%	43.5%	31.5%
日本	4.5%	6.0%	8.0%	8.8%	15.6%
歐洲	26.9%	26.9%	24.7%	12.8%	11.1%
晶圓收入分析					
以技術分類 （僅包括邏輯、記憶及銅連接件）	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	二零零五年 第一季	二零零四年 第四季	二零零四年 第三季

0.13 微米	43.8%	44.5%	29.2%	13.8%	11.9%
0.15 微米	2.7%	2.5%	12.5%	14.9%	13.2%
0.18 微米	45.3%	40.7%	40.3%	33.6%	46.2%
0.25 微米	3.1%	3.9%	4.6%	6.0%	6.4%
0.35 微米	5.1%	8.4%	13.4%	31.7%	22.3%
		<u>二零零五年</u>	<u>二零零五年</u>	<u>二零零五年</u>	<u>二零零四年</u>
以邏輯分類 (1)		<u>第三季</u>	<u>第二季</u>	<u>第一季</u>	<u>第四季</u>
					<u>第三季</u>
0.13 微米	14.7%	12.6%	5.4%	2.4%	1.8%
0.15 微米	5.3%	4.8%	2.2%	5.3%	4.6%
0.18 微米	67.4%	59.4%	59.8%	38.2%	56.2%
0.25 微米	4.0%	7.1%	7.1%	7.8%	6.1%
0.35 微米	8.6%	16.1%	25.5%	46.3%	31.3%

附注：

(1) 不包括 0.13 微米銅接連件

- 與二零零五年第二季相比，二零零五年第三季應用於消費類產品的晶片的銷售增長速度快于其他應用領域。
- 二零零五年第三季邏輯晶圓包括銅接連件的銷售占總銷售額的百分比與二零零五年第二季的 58.9% 相比上升至 65.5%。
- 二零零五年第三季源自北美客戶的銷售占總銷售額的百分比與二零零五年第二季度的 40.8% 相比，上升至 42.9%。
- 二零零五年第三季 0.18 微米及以下技術晶圓的銷售占晶圓銷售額百分比上升至 91.8%，二零零五年第二季度為 87.7% 而二零零四年第三季度為 71.3%。
- 二零零五年第三季 0.18 微米及以下技術邏輯晶圓的銷售額占邏輯晶圓銷售額的百分比上升至 87.4%，二零零五年第二季度為 76.8%，而二零零四年第三季度為 62.6%。

• **產能：**

<u>廠 / (晶圓尺寸)</u>	<u>二零零五年第三季⁽¹⁾</u>	<u>二零零五年第二季⁽¹⁾</u>
一廠 (8 吋)	43,000	45,000
二廠 (8 吋)	44,378	43,045
四廠 (12 吋)	21,605	16,787
七廠 (8 吋)	15,000	15,000
每月晶圓裝配總產能	123,983	119,832

銅接連件：		
三廠（8吋）	19,205	19,193
每月銅接連件總產能	19,205	19,193

附注：

（1）期終每月晶圓計，8吋等值

- 截至二零零五年第三季度末，基於一定的產品組合，每月產能增加至 143,188 件 8 吋等值晶圓。

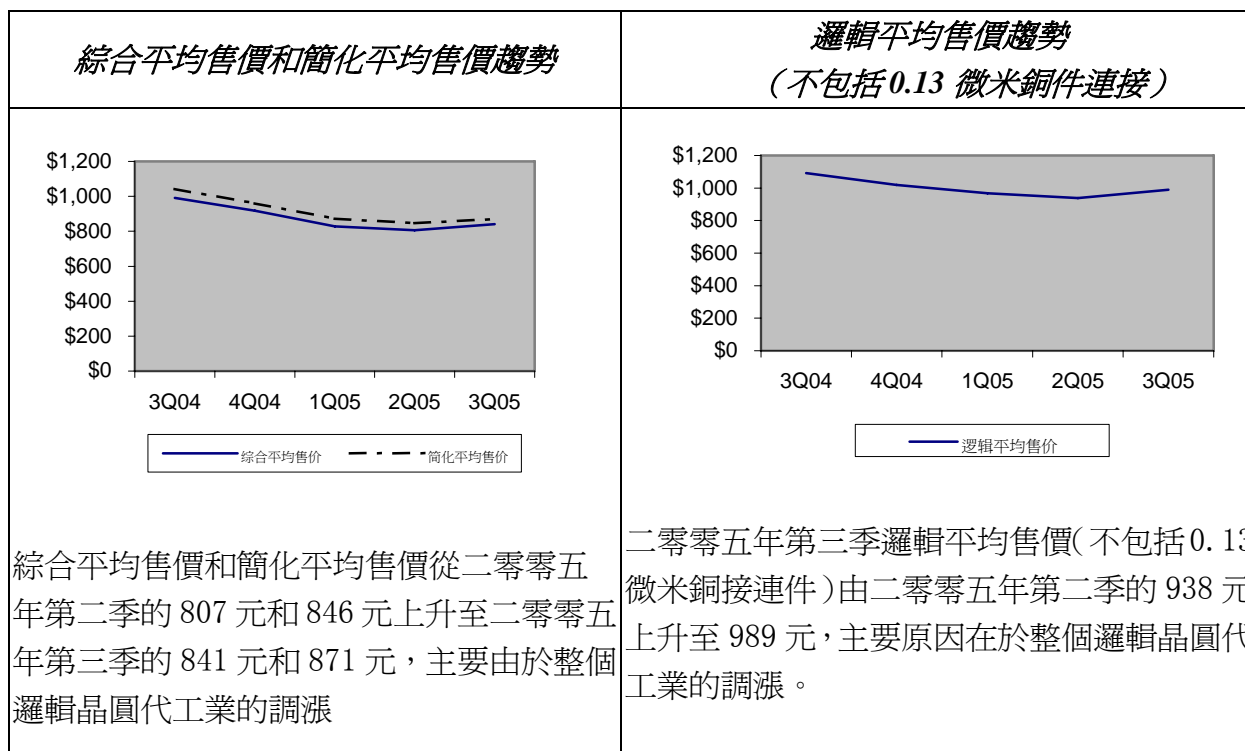
付運及使用率：

8吋晶圓	二零零五年	二零零五年	二零零五年	二零零四年	二零零四年
	第三季	第二季	第一季	第四季	第三季
付運晶圓（包括銅接連件）	355,664	330,499	284,912	303,796	263,808
使用率 ⁽¹⁾	92%	87%	85%	95%	99%

附注：

（1）使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

- 二零零五年第三季晶圓付運增加至 355,664 片 8 吋等值晶圓，分別較二零零五年第二季的 330,499 片及二零零四年第三季度的 263,808 片分別錄得季度升幅 7.6%及年度升幅 34.8%。
- 二零零五年第三季使用率上升至 92%。



2. 詳細財務分析

毛利分析

以千美元計	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	季度比較	二零零四年 第三季	年度比較
銷售成本	284,686	273,111	4.2%	201,141	41.5%
折舊	167,919	171,216	-1.9%	108,254	55.1%
其他製造成本	116,767	101,895	14.6%	92,887	25.7%
毛利	25,273	6,389	295.6%	73,756	-65.7%
毛利率	8.2%	2.3%		26.8%	

- 銷售成本從二零零五年第二季的 273,100,000 元增加 4.2%至二零零五年第三季的 284,700,000 元，主要由於晶圓付運的增加，因市場預期價值的下降而引起的存貨價值下調以及許可產品的技術使用費支出。
- 二零零五年第三季毛利為 25,300,000 元，與二零零五年第二季的 6,400,000 元相比錄得季度升幅 295.6%，與二零零四年第三季的 73,800,000 元相比錄得年度降幅 65.7%。
- 毛利率從二零零五年第二季的 2.3%上升至二零零五年第三季 8.2%，主要是綜合平均售價上升。

經營開支分析

以千美元計	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	季度比較	二零零四年 第三季	年度比較
總經營開支	46,219	38,469	20.1%	31,218	48.1%
研究及開發	19,230	16,344	17.7%	18,427	4.4%
一般及行政	9,122	5,397	69.0%	3,831	138.1%
銷售及市場推廣	4,072	3,012	35.2%	1,899	114.4%
取得無形資產攤銷	10,661	10,082	5.7%	3,507	203.9%
遞延股份報酬攤銷	3,135	3,634	-13.7%	3,554	-11.8%

- 總經營開支從二零零五年第二季的 38,500,000 元升至 46,200,000 元，錄得季度升幅 20.1%。
- 研發費用從二零零五年第二季的 16,300,000 元上升 17.7% 至二零零五年第三季 19,200,000 元，主要是由於 90 奈米的研究開發行為以及北京晶圓 6 廠啓動費用增加所致。
- 一般行政費用(包括匯兌損益)從二零零五年第二季 5,400,000 元上升 69.0% 至二零零五年第三季 9,100,000 元。二零零五年第三季與經營活動相關的匯兌虧損為 300,000 元，而二零零五年第二季為匯兌收益 2,500,000 元。
- 銷售及市場推廣相關費用從二零零五年第二季 3,000,000 元上升 35.2% 至二零零五年第三季 4,100,000 元，差額主要因為與銷售行為相關的工程材料費用增加。
- 取得無形資產攤銷是指與所獲得無形資產相關的攤銷費用，此費用從二零零五年第二季 10,100,000 元上升 5.7% 至二零零五年第三季 10,700,000 元。

非經營收入(支出)

以千美元計	二零零五年 第三季	二零零五年 第二季	季度比較	二零零四年 第三季	年度比較
其他收入(支出)	(5,602)	(8,234)	-32.0%	(3,194)	75.4%
利息收入	3,278	2,030	61.5%	3,107	5.5%
利息支出	(10,334)	(8,971)	15.2%	(3,614)	185.9%
其他，淨額	1,454	(1,293)	-	(2,687)	

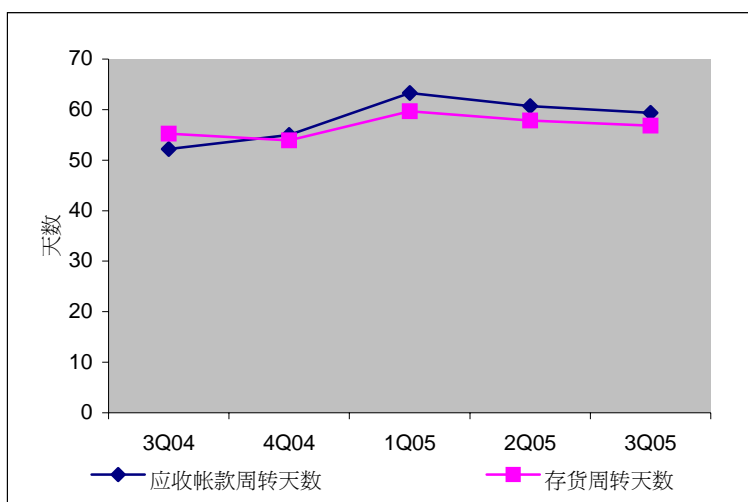
- 二零零五年第三季其他非營業性虧損為 5,600,000 元，相較於二零零五年第二季度虧損 8,200,000 元下降了 32%。

- 二零零五年第三季的利息支出由二零零五第二季的 9,000,000 元增加 15.2% 至 10,300,000 元，主要是由於銀行借款增加以及利率上升所至。

3. 流動資金

以千美元計	二零零五年第三季	二零零五年第二季
現金及現金等價物	576,767	576,292
短期投資	5,582	2,768
應收賬款	212,823	196,132
存貨	182,851	176,502
其他	12,582	16,397
總流動資產	990,605	968,091
應付賬款	259,797	249,595
短期借款	266,589	224,000
長期借款的即期部份	246,081	228,625
其他	113,154	96,746
總流動負債	885,621	798,966
現金比率	0.7x	0.7x
速動比率	0.9x	1.0x
流動比率	1.1x	1.2x

應收賬款／存貨的各日走勢



資本結構

以千美元計	二零零五年第三季	二零零五年第二季
現金及現金等價物	576,767	576,292
短期投資	5,582	2,768
長期票據的即期部分	19,578	19,090
長期票據	116,749	116,204
短期借款	266,589	224,000
長期借款的即期部份	246,081	228,625
長期借款	444,566	511,807
總借款	957,236	964,432
現金淨額	(511,214)	(520,666)
股東權益	3,034,237	3,053,111
總借款對權益比率	31.5%	31.6%

-
-

4. 現金流量及資本開支

以千美元計	二零零五年第三季	二零零五年第二季
虧損淨額	(26,115)	(40,445)
折舊及攤銷	192,347	185,978
購入無形資產攤銷	10,661	10,082
現金變動淨額	474	137,491

資本開支

- 二零零五年第三季資本開支為 189,230,000 元。
-

5. 二零零五年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已于之前的安全港聲明中闡明。

- 晶圓付運預期微增長。
- 使用率預計至 92%-93%。
- 綜合 ASP 季度預計持平或微上升。
- 毛利率預計至 8%-11%。
- 經營開支相對銷售的百分比預計增長至 15%-19%，主要由於針對 90 奈米的研究發展活動支出增加所致。
- 非經營利息支出預期約與二零零五年第三季度持平。
- 資本開支約為 250,000,000 元至 300,000,000 元。
- 折舊及攤銷約為 210,000,000 元至 215,000,000 元。

6. 近期公佈

- 中芯國際二零零五年技術研討會在深圳召開。(二零零五年十月十三日)
- 中芯國際與重慶重郵信科成功製造 0.13 微米 3G 手機專用晶片。(二零零五年十月十二日)
- 中芯國際與朗明科技簽訂協定聯合開發 65 奈米及以下制程技術。(二零零五年十月六日)
- 中芯國際二零零五年技術研討會首次在韓國召開。(二零零五年九月二十八日)
- 中芯國際公佈截至二零零五年六月三十日止，六個月的未經審核中期業績及更新二零零五年第三季指引。(二零零五年九月二十三日)
- 中芯國際二零零五年技術研討會在北京召開。(二零零五年八月二十六日)
- 中芯國際出席第三屆中國國際積體電路產業展覽會(二零零五年八月二十四日)
- 中芯國際通過 BS7799 資訊安全管理體系認證(二零零五年八月十二日)
- 中芯國際二零零五年第二季業績報告(二零零五年七月二十九日)

- 中芯國際獲特許 SAIFUN NROM 技術用於擴大其半導體事業（二零零五年七月二十八日）
- 中芯國際宣佈委任王陽元教授為董事長（二零零五年七月二十八日）
- 中芯國際與新思科技有限公司發佈設計參考流程 2.0（二零零五年七月二十日）
-
-

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

中芯財務資料

合并資產負債表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零五年九月三十日 (未經審核)	二零零五年六月三十日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	576,766,591	576,292,179
短期投資	5,581,511	2,768,085
應收賬款，已扣除撥備（二零零五年九月三十日為284,091元，二零零五年六月三十日為109,362元）	212,822,764	196,132,014
存貨	182,850,604	176,502,315
預付款項及其它流動資產	12,583,729	14,564,660
待售資產	-	1,831,972
流動資產合計	990,605,199	968,091,225
土地使用權，淨額	38,136,980	38,758,108
廠房及設備，淨額	3,284,892,971	3,309,941,020
購入無形資產，淨額	202,843,555	192,817,289
長期投資	18,340,174	9,524,730
資產合計	4,534,818,879	4,519,132,372
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	259,796,976	249,594,589
預提費用及其它流動負債	93,576,700	77,655,608
短期借款	266,589,185	224,000,435
長期票據的即期部份	19,577,936	19,090,094
長期借款的即期部份	246,080,580	228,625,170
流動負債合計	885,621,377	798,965,896
長期負債：		

長期票據	116,748,925	116,203,745
長期借款	444,566,420	511,806,547
其他長期應付款	15,039,304	-
長期負債合計	576,354,649	628,010,292
負債合計	1,461,976,026	1,426,976,188
承諾		
少數股權	38,605,893	39,044,852
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零五年九月三十日已發行股份為 18,282,217,408 股，未發行的股份為 18,246,615,105 股。	7,312,888	7,298,647
認股權證	32,387	32,387
額外繳入股本	3,290,310,978	3,289,932,622
應收股東票據	(247,137)	(287,629)
累計其他綜合盈餘	794,214	67,782
遞延股票報酬	(31,025,668)	(37,107,243)
累計虧絀	(232,940,702)	(206,825,234)
所有股東權益合計	3,034,236,960	3,053,111,332
總負債及股東權益合計	4,534,818,879	4,519,132,372

合并營運報表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零五年九月三十日 (未經審核)	二零零五年六月三十日 (未經審核)
銷售額	309,959,083	279,500,151
銷售成本	281,908,983	270,068,286
銷售成本—遞延股票報酬攤銷	2,777,550	3,043,259
毛利	25,272,550	6,388,606
經營費用：		
研究和開發	19,229,715	16,343,815
一般管理	9,121,980	5,396,571
銷售和市場推廣	4,071,957	3,012,598
購入無形資產攤銷	10,660,670	10,081,688
遞延股票報酬攤銷*	3,134,817	3,634,441
經營費用總額	46,219,139	38,469,113
經營虧損	(20,946,589)	(32,080,507)
其他收入(支出)：		
利息收入	3,277,964	2,029,899
利息支出	(10,333,503)	(8,970,776)
其他淨額	1,453,794	(1,293,508)
其他淨收入(支出)總額	(5,601,745)	(8,234,385)
稅前虧損淨額	(26,548,334)	(40,314,892)
所得稅	6,068	118,449
少數股權	438,934	(11,947)
淨虧損	(26,115,468)	(40,445,288)
視為已派付優先股股息	-	-

普通股持有人應占虧損淨額	(26,115,468)	(40,445,288)
每股股份收入淨額，基本	(0.0014)	(0.0022)
每股美國預托股份收入淨額，基本(1)	(0.0718)	(0.1113)
每股股份收入淨額，攤薄	(0.0014)	(0.0022)
每股美國預托股份收入淨額，攤薄(1)	(0.0718)	(0.1113)
用作計算基本每股收入淨額的股份（以百萬計）	18,180	18,169
用作計算攤薄每股收入淨額的股份（以百萬計）	18,180	18,169
* 遞延股票報酬攤銷乃關於：		
研究和開發	1,125,943	1,246,376
一般和管理	1,403,732	1,810,959
銷售及市場推廣	605,142	577,106
總計	3,134,817	3,634,441

(1) 一股美國預托股份等於 50 股普通股。

合并现金流量表
(美元)

	截至以下日期止三個月	
	二零零五年九月三十日 (未經審核)	二零零五年六月三十日 (未經審核)
經營活動：		
普通股持有人應占虧損	(26, 115, 468)	(40, 445, 288)
視為已派付優先股息	-	-
淨虧損	(26, 115, 468)	(40, 445, 288)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：		
少數股權	(438, 934)	11, 947
出售廠房及設備的收益(虧損)	(1, 245, 543)	23, 609
(沖銷)呆賬撥備	174, 729	(233, 406)
折舊及攤銷	192, 347, 054	185, 977, 726
購入無形資產攤銷	10, 660, 671	10, 081, 688
遞延股票報酬攤銷	5, 912, 367	6, 677, 700
非現金長期票據利息費用	1, 033, 022	1, 150, 866
長期投資虧損	784, 556	5, 579
營運資產及負債的變動：		
應收賬款	(16, 865, 479)	(15, 021, 064)
存貨	(6, 348, 289)	(1, 977, 063)
預付款及其它流動資產	2, 864, 683	(7, 684, 704)
應付賬款	24, 244, 703	(872, 935)
預提費用及其它流動負債	12, 330, 949	(2, 661, 260)
經營活動所得現金淨額	199, 339, 021	135, 033, 395
投資活動：		
購入廠房及設備	(188, 180, 850)	(227, 154, 585)
購買所獲無形資產	(2, 663, 628)	(2, 353, 756)
購入短期投資	(5, 217, 982)	(2, 416, 480)
長期投資已付款項	(9, 600, 000)	(6, 720, 000)
出售短期投資	2, 412, 898	10, 000, 000
出售生活園區已收款項	4, 614, 394	1, 111, 677

投資活動所耗現金淨額	(198,635,168)	(227,533,144)
融資活動：		
短期借款所得款項	91,918,751	145,540,347
長期借款所得款項	74,985,000	99,943,394
償還長期借款支付的款項	(124,769,718)	-
償還短期借款支付的款項	(49,330,000)	(55,000,000)
行使雇員購股權所得款項	561,806	777,415
收取雇員應收認購款項	40,492	51,529
少數股權所得款項	-	39,000,025
政府撥款所得款項	6,456,486	-
融資活動所得現金淨額	(137,183)	230,312,710
匯率變動的影響	(92,258)	(322,315)
現金及現金等價物減少淨額	474,412	137,490,646
現金及現金等價物—二零零五年七月一日	576,292,179	438,801,533
現金及現金等價物—二零零五年九月三十日	576,766,591	576,292,179

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席及獨立非執行董事王陽元、執行董事張汝京、非執行董事蔡來興、姚方（蔡來興的替任董事）、獨立非執行董事徐大麟、周延鵬、川西剛、蕭崇河及陳立武。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

首席執行官

張汝京

上海，二零零五年十月二十八日

* 僅供識別